

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称	宝盈基金管理有限公司 北京泽铭投资有限公司 博时基金管理有限公司 长安基金管理有限公司 长城财富（北京）投资管理有限公司 长城基金管理有限公司 创金合信基金管理有限公司 大成基金管理有限公司 东吴证券研究所 GIC 新加坡政府投资基金 工银安盛资产管理有限公司 光大保德信基金管理有限公司 广发基金管理有限公司 广银理财有限责任公司 国君资管 国寿养老 国泰君安证券股份有限公司 国新自营 泓德基金管理有限公司 红思客资产管理(北京)有限责任公司 红塔红土基金管理有限公司 华宝基金管理有限公司 华泰保兴基金管理有限公司 华夏理财 汇丰晋信基金管理有限公司 江信基金管理有限公司 建信理财有限责任公司 交银施罗德基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 开源自营

	摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 南方基金管理股份有限公司 宁银理财有限责任公司 诺安基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司 平安基金管理有限公司 平安养老保险股份有限公司 前海开源基金管理有限公司 RedCotton 上海德汇集团有限公司 上海和谐汇一资产管理有限公司 上海行知创业投资有限公司 上海信托 上海侏罗纪资产管理合伙企业（有限合伙） 上银基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 深圳市伯利恒资产管理有限公司 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 太平养老保险股份有限公司 太平资产管理有限公司 天风证券股份有限公司 途灵资产 WARD FERRY MANAGEMENT LTD. 西部证券股份有限公司 谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司 西南证券股份有限公司 兴业基金管理有限公司 新华基金管理股份有限公司 鑫元基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 Yuanhao Greater China Fund 长信基金管理有限责任公司 招银理财有限责任公司 浙江乾瞻投资管理有限公司 中国中信金融资产管理股份有限公司 中海基金管理有限公司 中金公司 中金汇理资产管理有限公司 中泰证券股份有限公司 中天证券 中信建投资本管理有限公司
时间	2026 年 8 月 28 日

地点	电话会议
上市公司 接待人员 姓名	副总经理兼董事会秘书 万建军先生 投资者关系总监 吴斯文先生
投资者关 系活动主 要内容介 绍	Q&A Q： 2026 年上半年公司分业务的营收、增速以及下游需求情况如何？ A： 2026 年上半年公司三大板块收入情况如下：智能视频板块实现营业收入 8.82 亿元，同比增长 120%左右；智能物联板块实现收入 3.63 亿元，同比增长近 180%，是增速最高的板块；智能出行板块同比增长 62%左右。各板块收入的大幅增长均由销售量与销售单价共同上升贡献，目前下游客户需求态势良好，增长势头有望延续。 Q： 公司合封 DDR 芯片的营收占比是多少？存储成本上升会对公司后续成本带来什么影响，公司有哪些应对措施？ A： 此前公司的 SoC 芯片基本都采用合封 DDR 的路线，因此绝大部分收入来自合封芯片。针对当前存储价格大幅上升的情况，公司有三类解决方案：第一是替代方案，在部分基础型号产品中用 PSRAM 替代小容量 DDR，为客户提供更多选择；第二是外挂型方案，推出外挂 DDR 型芯片，将存储采购环节向下游转移，客户可自行通过不同渠道采购存储芯片。目前公司已具备合封芯片、PSRAM 替代、外挂型芯片三类解决方案，预计在存储成本偏高的背景下，PSRAM 替代和外挂型方案的占比会逐步提升。 Q： 公司应对上游存储成本上涨的调价幅度是多少？现有客户对涨价的接受度如何？调价效应是否已在 2026 年上半年完全体现？ A： 公司从 2025 年 Q4 上游存储价格开始上涨时，就及时与客户沟通并传递涨价信息，涨价接受度整体较好，经过多轮涨价后，当前部分存储产品价格已处于高位，不同领域客户接受度出现分化：专业视频领域客户接受度仍较好，消费领域非头部客户已出现成本承压的情况。针对消费领域客户的压力，公司提前布局了两种降本方案，第一种是行业内率先采用价格更低的 PSRAM 替代 DDR，推出相关产品；第二种是 2026 年 Q1 就向客户推出外挂型芯片方案，后续也加大了该方向的规划，目前偏消费领域客户更多选择外挂方案和 PSRAM 方案，调价效应已在经营端逐步体现。 Q： 公司如何看待 2026 年下半年及 2027 年的存储价格走势？涨幅是否会放缓？

	A: 从当前情况来看, 存储涨价趋势暂无缓解迹象, 预计还会持续, 目前正在和上游供应商沟通 2026 年 Q4 的价格, 暂时无法明确价格是否会在 Q4 得到缓解。供应端紧张的核心原因是高端 HBM、DDR5 等产品受 AI 需求拉动并沿规格逐级传导, 需求趋势未明显减缓, 且相关产能扩产周期较长, 因此分给利基型存储产品的整体供应量仍会趋紧。 Q: 公司 2026 年下半年的存储供应是否充足? 2027 年备货水平是否处于健康区间? A: 公司客户以涨价吸纳能力较强的品牌客户为主, 公司会尽最大努力保障客户的供应, 目前供应情况稳定。 Q: 公司 2026 年二季度收入环比增长近 60%, 对应的量价变化可以做一下拆分吗? A: 从上半年数据来看, 公司三大业务板块均实现量价齐升: 销量方面, 每个板块的销量均有至少 50% 的增长; 单价方面, 各板块单价均有上升, 其中智能物联板块单价涨幅最高, 智能视频板块涨幅居中, 智能出行板块受存储价格影响最小, 因此涨幅最小。 Q: 2026 年以来公司毛利率持续环比提升, 下半年的毛利率趋势如何? A: 此前毛利率上升有两方面原因: 一是产品价格上涨传导至客户端, 叠加前期备货因素的影响; 二是上游供应紧张背景下, 价格向客户传导的力度较大。对于后续趋势: 2026 年 7 月公司已对 Q3 产品价格进行调整, Q4 继续实现较大幅度涨价的难度较高。公司不会采用收割式的涨价策略, 追求与客户的长期合作关系, 预计三季度毛利率大幅向上的难度较大, 整体将保持相对平稳的状态。 Q: 上游代工、封测环节的价格变动对公司成本有什么影响? A: 封测环节: 国内封装厂有一定价格调整, 但封测成本在公司整体芯片成本占比很小, 基本不会对毛利率构成影响。晶圆环节: 目前晶圆供应商没有调价, 且与供应商沟通确认 2027 年晶圆价格也不会上涨。 Q: 目前公司下游大客户的库存水位情况如何, 和涨价前相比有什么变化? A: 2025 年客户去库存力度较大, 库存水平低于常年, 2026 年客户适当补充了库存, 但目前估计库存水平仍低于历史高位, 处于合理区间。 Q: 从 2026 年 7、8 月的订单情况来看, 除了存储推动的备货需求外, 终端
--	---

	真实需求是否有增长，是否存在客户提前拉货的情况？ A：公司对客户的正常生产需求有充分掌握，在当前涨价、货源供应紧张的背景下，公司依然维持合理分配，不倾向支持客户超前拉货。从供应端来看，目前整体供应偏紧，下游市场集中度向品牌客户、有竞争优势的客户集中，公司现有客户反馈的需求情况较为乐观。 Q： 智能视频业务中，安监领域的收入占比是多少？工业视觉、机器人等新市场的导入进度如何？ A：智能视频业务中，安监领域的收入仍占绝大部分。人形机器人领域：公司已经向数家头部人形机器人客户供货，目前客户总出货量为数万级，对公司业绩贡献较小，公司已切入相关供应链，待下游放量后可快速跟进。工业视觉领域：公司相关产品已完成量产出货，实现近千万级别的销售收入。 Q： 公司智能出行业务的产品可以覆盖哪些汽车细分应用场景？目前单车价值量、单车搭载量分别是什么水平？ A：公司车载产品已覆盖 DMS 驾驶员监控、OMS 乘客监控、CMS 电子后视镜、流媒体后视镜、AVM 环视、车载 DVR 等诸多场景，具备覆盖单车 8-10 个摄像头的的能力，目前客户选用的搭载量普遍在单车 3-4 个，从单车数量角度看仍有较大提升空间。价格方面，不含存储的车载芯片单价 5 美金以内，含存储的高端车载芯片单价已上涨至十几美金。 Q： 公司车载产品拓展更多车规场景的认证周期大概是多久？ A：公司此前作为行业新进入者时，一款车规芯片的认证周期需要 1-2 年，目前公司已获得较多客户认可，如果车型已有 3-4 个摄像头采用公司产品，后续新增场景的认证速度会比之前更快。 Q： 公司边缘侧 AI SoC 芯片的参数、应用场景是什么？目前客户导入进展如何？ A：该芯片即将推出，目前正与部分客户做方案探讨，预计 2026 年下半年启动客户开发验证，2027 年开始形成收入。应用场景方面，初期主要聚焦两大方向：一是家庭智能终端，比如 NAS；二是电力行业巡检机器人相关设备，初期不会拓展过多过广的客户。 Q： 公司除边缘侧新品外，还有哪些新市场、新场景的核心新品规划？预计放量节奏如何？
--	---

	A: 公司新品规划主要包括三个方向: 一是可穿戴摄像机等智能终端的芯片, 二是安卓芯片, 三是 AI-ISP 的车载芯片。这些新品预计在 2027 年 Q2 到 Q3 逐步放量, 对公司销售收入形成贡献。 Q: 未来 2-3 年公司智能视频、智能出行、物联网三大业务的核心增长点是什么? 收入占比趋势如何? 核心增量来自哪个板块? A: 未来增长点主要来自现有优势领域的产品迭代, 以及前述新品的客户拓展与落地。公司规划未来 3-5 年 (预计快于 5 年) 营收突破 40 亿元, 三大业务收入占比预计为 2:1:1, 核心增量主要来自 IoT 和车载两大新兴板块。 Q: 公司目前现金储备充沛, 未来是否有外延并购的规划? 主要布局方向是什么? A: 公司一直在关注合适的并购标的, 如果有合适的标的会积极开展资本市场运作, 并购方向主要围绕产业链横向和纵向的相关标的。 Q: AI 端侧升级是否会推动视觉 SoC 产品升级换代? 产品 ASP 的提升幅度有多大? A: AI 技术向视觉 SoC 产品的渗透会越来越深远, 相关升级是必然趋势: 第一, 在成像效果上, AI 技术可提升复杂环境、暗光环境下的画面清晰度与色彩还原度, 满足“看得清、看得懂”的刚性需求; 第二, 在编码效率上, AI 编码可在不损失画面质量的前提下降低码率, 更适配无线传输场景的需求。升级会带来产品价值量的提升, 一方面芯片面积会加大, 另一方面部分产品为降低功耗会向更先进工艺跃迁, 成本提升会推动产品向高端化发展, 售价也会随之上涨。 Q: 目前公司视觉 SoC 产品集成算力的情况如何? 后续在算力相关产品上有什么规划? A: 公司当前的技术路线以“用合适的算力解决实际问题”为核心, 并不单纯追求大算力: 第一, AI ISP、AI 编码等刚性需求, 匹配适用算力即可满足功能要求; 第二, 前几年 AI 技术迭代速度快, 客户对算力、支持的网络类型需求尚未明确, 因此相关集成进度较慢。目前客户侧大模型开发已较为成熟, 对算力、算子支持的需求已非常清晰, 公司后续会开发搭载中大算力、支持特殊算子的相关产品。
附件清单	无

(如有)	
日期	2026 年 8 月 28 日